

ザイリンクス、TSMC の 7nm プロセス テクノロジーにより、 第 4 世代 All Programmable テクノロジーのリーダーシップを確立し、 マルチノード スケーリングのアドバンテージを実現

第 4 世代のアドバンスド プロセスおよび 3D IC テクノロジー、第 4 世代の FinFET テクノロジー

ザイリンクス社 (本社 : 米国カリフォルニア州サンノゼ、NASDAQ : XLNX) は 5 月 28 日 (米国時間)、同社の次世代 All Programmable FPGA、MPSoC および 3D IC の開発に向けて、TSMC 社の 7nm プロセスおよび 3D IC テクノロジーを利用することを発表した。これは、両社が協業して開発した第 4 世代のアドバンスド プロセスおよび CoWoS 3D スタッキング テクノロジーと、TSMC 社にとって第 4 世代となる FinFET テクノロジーを利用している。この協業によってザイリンクスは、マルチノード スケーリングのアドバンテージを実現し、28nm、20nm および 16nm ノードにおける同社の優れた製品、業務遂行および市場での成功をさらに発展させていく。

ザイリンクスの社長兼 CEO であるモーシェ ガブリエロフ (Moshe Gavrielov) は、「TSMC 社は、ザイリンクスが 28nm、20nm、16nm プロセス と 3 世代続けて成功する基盤を提供してくれました。TSMC 社の優れたプロセス テクノロジー、3D スタッキング テクノロジー、ファウンドリ サービスを活用することによって、ザイリンクスは製品の優秀さ、品質、業務遂行、市場でのリーダーシップにおいて比類のない評価を確立することができました。また、TSMC 社は、新世代 SoC、MPSoC および 3D IC をはじめとするザイリンクスのプロダクト ポートフォリオに変化をもたらし、ワールド クラスの FPGA の開発に大きく貢献しています。TSMC 社の 7nm テクノロジーは、ザイリンクスにさらなる成長をもたらすものと信じています」と述べている。

TSMC 社の 社長兼 Co-CEO であるマーク リュー (Mark Liu) 氏は、「TSMC は、ザイリンクスとの協業により、ザイリンクス社の第 4 世代にあたる革新的な製品を提供できることをうれしく思います。過去数世代に渡る両社の協業の実績に基づいた次世代のスケールアップと 3D インテグレーション技術を提供していきます」と述べている。

ザイリンクスは新しい 7nm 製品を 2017 年に導入予定である。

ザイリンクスについて

ザイリンクスは、All Programmable FPGA および SoC、3D IC の世界的なリーディング プロバイダーである。業界をリードするこれらのデバイスを次世代設計環境および IP とともに提供することで、プログラマブル ロジックからプログラマブル システム インテグレーションまで、幅広いユーザー ニーズに応える。詳しい情報は、ウェブサイト japan.xilinx.com で公開している。

※ ザイリンクスの名称およびロゴ、Artix、ISE、Kintex、Spartan、Virtex、Vivado、Zynq、その他本プレスリリースに記載のブランド名は米国およびその他の各国のザイリンクスの登録商標または商標です。その他すべての名称は、それぞれの所有者に帰属します。

このプレスリリースに関するお問い合わせは下記へ

ザイリンクス株式会社 マーケティング部 神保 TEL: 03-6744-7740/FAX: 03-5436-0532

株式会社井之上パブリックリレーションズ ザイリンクス広報担当 鈴木/関 TEL: 03-5269-2301/FAX: 03-5269-2305

下記のザイリンクス株式会社ウェブサイトもご参照ください。

- トップページ : <http://japan.xilinx.com/index.htm>
- プレスリリース (日本語) : http://japan.xilinx.com/japan/j_prs_rls/
- このリリースの全文は次の URL を参照のこと :
http://japan.xilinx.com/japan/j_prs_rls/2015/7nm/xilinx-partners-with-tsmc.htm